

2020-2025年中国半导体用环氧塑封料市场前景预测及投资规划研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2020-2025年中国半导体用环氧塑封料市场前景预测及投资规划研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/487197.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章环氧塑封料产品概述

- 1.1环氧塑封料产品定义
- 1.2环氧塑封料的发展历程与产业现况
- 1.3环氧塑封料技术发展趋势
- 1.4环氧塑封料在半导体产业中的重要地位

第二章环氧塑封料的组成、品种分类及生产过程

- 2.1环氧塑封料产品组成
- 2.2环氧塑封料产品品种分类
 - 2.2.1按其主要组成
 - 2.2.2按其专业用途
 - 2.2.3按其施工条件
 - 2.2.4按其包装形态
- 2.3环氧塑封料制作过程
- 2.4环氧塑封料产品性能
 - 2.4.1未固化物理性能
 - 2.4.2固化物理性能
 - 2.4.3机械性能

第三章环氧塑封料的应用及其主要市场领域

- 3.1ic封装的塑封成形工艺过程
 - 3.1.1ic封装塑封成形的工艺过程
 - 3.1.2ic封装塑封成形的工艺要点
 - 3.1.3ic封装塑封成形的质量保证
- 3.2环氧塑封料的应用领域

第四章全球半导体封测产业概况及市场分析

- 4.1世界半导体封装业发展特点
- 4.2世界半导体封装产品的主要生产制造商
- 4.3世界半导体封装业的发展现状
 - 4.3.12019年世界半导体产业与市场概况
 - 4.3.2世界封测产业与市场概况
- 4.4世界封测产业的发展总趋势
- 4.5世界封测生产值统计

第五章我国半导体封测产业概况及市场分析

- 5.12019年我国半导体产业发展状况
- 5.2我国集成电路封测业发展现状
 - 5.2.1我国集成电路产业发展
 - 5.2.2我国集成电路封测产业发展现状
 - 5.2.2.1我国ic封测产业市场规模现状
 - 5.2.2.2我国ic封测厂家分布及产能
 - 5.2.2.3我国ic封测业的骨干生产企业情况
 - 5.2.2.4我国ic封测业内资企业在近期的技术发展
- 5.3我国半导体分立器件封测业发展现状
 - 5.3.1我国半导体分立器件生产现状
 - 5.3.2我国半导体分立器件行业发展特点
 - 5.3.3我国半导体分立器件产业地区分布及市场结构
 - 5.3.4我国半导体分立器件生产厂家情况
 - 5.3.5我国半导体分立器件市场发展前景

第六章世界环氧塑封料产业的生产与技术现状

- 6.1世界环氧塑封料生产与市场总况
- 6.2世界环氧塑封料主要生产企业概述
- 6.3日本环氧塑封料生产厂家现状
 - 6.3.1住友电木 (sumitombakelite)
 - 6.3.2日东电工 (nittodenko)
 - 6.3.3日立化成 (hitachichemical)
 - 6.3.4松下电工株式会社 (matsushitaelectric)
 - 6.3.5信越化学工业 (shin-etsuchemical)
 - 6.3.6京瓷化学 (kyocerachemical)

6.4台湾长春人造树脂现状

6.5韩国环氧塑封料生产厂家现状

6.5.1三星SDI

6.5.2韩国kcc

6.6汉高集团（hysol）塑封料生产现状

第七章我国环氧塑封料产业现状及国内市场需求

7.1我国环氧塑封料业的发展现状

7.2我国环氧塑封料业生产情况

7.3我国环氧塑封料业技术水平现况

7.3.1环氧塑封料的工艺选择

7.3.2塑封料性能对器件可靠性的影响

7.4我国国内环氧塑封料的市场需求情况

7.5未来几年我国环氧塑封料行业的市场发展趋势预测

7.6我国环氧塑封料的主要生产厂家情况

7.6.1汉高华威电子有限公司

7.6.2长兴电子材料(昆山)有限公司

7.6.3南通住友电木有限公司

7.6.4日立化成工业（苏州）有限公司

7.6.5北京科化新材料科技有限公司

7.6.6佛山市亿通电子有限公司

7.6.7浙江恒耀电子材料有限公司

7.6.8江苏中鹏电子有限公司

7.6.9广州市华塑电子有限公司

7.6.10松下电工（上海）电子材料有限公司

7.6.11北京中新泰合电子材料科技有限公司

7.6.12长春封塑料（常熟）有限公司

7.6.13无锡创达电子有限公司

7.6.14广东榕泰实业股份有限公司

第八章环氧塑封料生产主要原材料及其需求

8.1emc用环氧树脂

8.1.1emc对环氧树脂原料的要求

8.1.2世界及我国环氧树脂业发展现状

8.1.3国内环氧树脂产业的原材料供应情况

8.1.3.1双酚a

8.1.3.2环氧氯丙烷（ech）

8.1.4绿色化塑封料中的环氧树脂开发情况

8.2emc用硅微粉

8.2.1emc对硅微粉原料的要求

8.2.2emc用硅微粉产品概述

8.2.3国外emc用硅微粉产品生产的现况

8.2.3.1日本emc用硅微粉的生产现况

8.2.3.2北美emc用硅微粉的生产现况

8.2.3.3欧洲emc用硅微粉的生产现况

8.2.4国内emc用硅微粉产品生产的现况

图表目录：

图表：2019年半导体产业资本支出额企业占比

图表：2019年部分封测企业收入（仅包含纯代工封装企业）

图表：集成电路产业结构

图表：2015-2019年全球半导体设备销售收入

图表：2015-2019年中国半导体设备销售占比

图表：2015-2019年中国ic封测产业销售规模

图表：2015-2019年中国半导体分立器件行业产量

图表：2015-2019年中国半导体分立器件市场规模

图表：我国半导体分立器件生产厂家

图表：2015-2019年全球环氧塑封料行业产量

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/487197.html>